

合肥颀中科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-023

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	申万菱信基金、中邮证券、信达澳亚基金
时间	2024年8月20日-2024年8月21日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司主要客户有哪些？ 答：公司主要客户有瑞鼎、集创北方、奕斯伟、云英谷、联咏、格科微、OMNIVISION TOUCH AND DISPLAY、敦泰、通锐微等。</p> <p>2. 问：近期黄金价格上涨，对于公司产品成本是否有所影响？ 答：黄金主要用于显示驱动芯片上，而公司目前生产上所用到的黄金成本基本可转嫁至下游客户，由其承担价格波动的主要风险，因此近期的黄金价格波动对公司产品成本影响不大。</p> <p>3. 问：公司产品的终端应用的营收占比如何？ 答：由于公司仅为客户提供封装测试服务，客户不会明确告知所封测芯片的终端应用情况，因此公司结合产品指标、下游客户收入结构等特性，分析所封测芯片的主要终端应用领域情况。根据公司初步统计：2024年上半年，显示业务方面，智能手机占比约50%，液晶电视占比约36%，笔记本电脑约为7%；非显示业务方面，电源管理占比约50%，射频前端占比接近45%。</p> <p>4. 问：合肥厂的产能爬坡期预计多久？ 答：产能爬坡期预计为3-6个月不等，具体需按实际情况推进。</p> <p>5. 问：苏州、合肥工厂的定位分别是什么？ 答：结合合肥上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情况，合肥厂预计以显示业务为主，负责12吋晶圆的封装测试，</p>

	苏州厂则是显示驱动芯片封测和非显示类芯片封测齐头并进，未来着重侧重于非显示类芯片封测的发展。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月21日